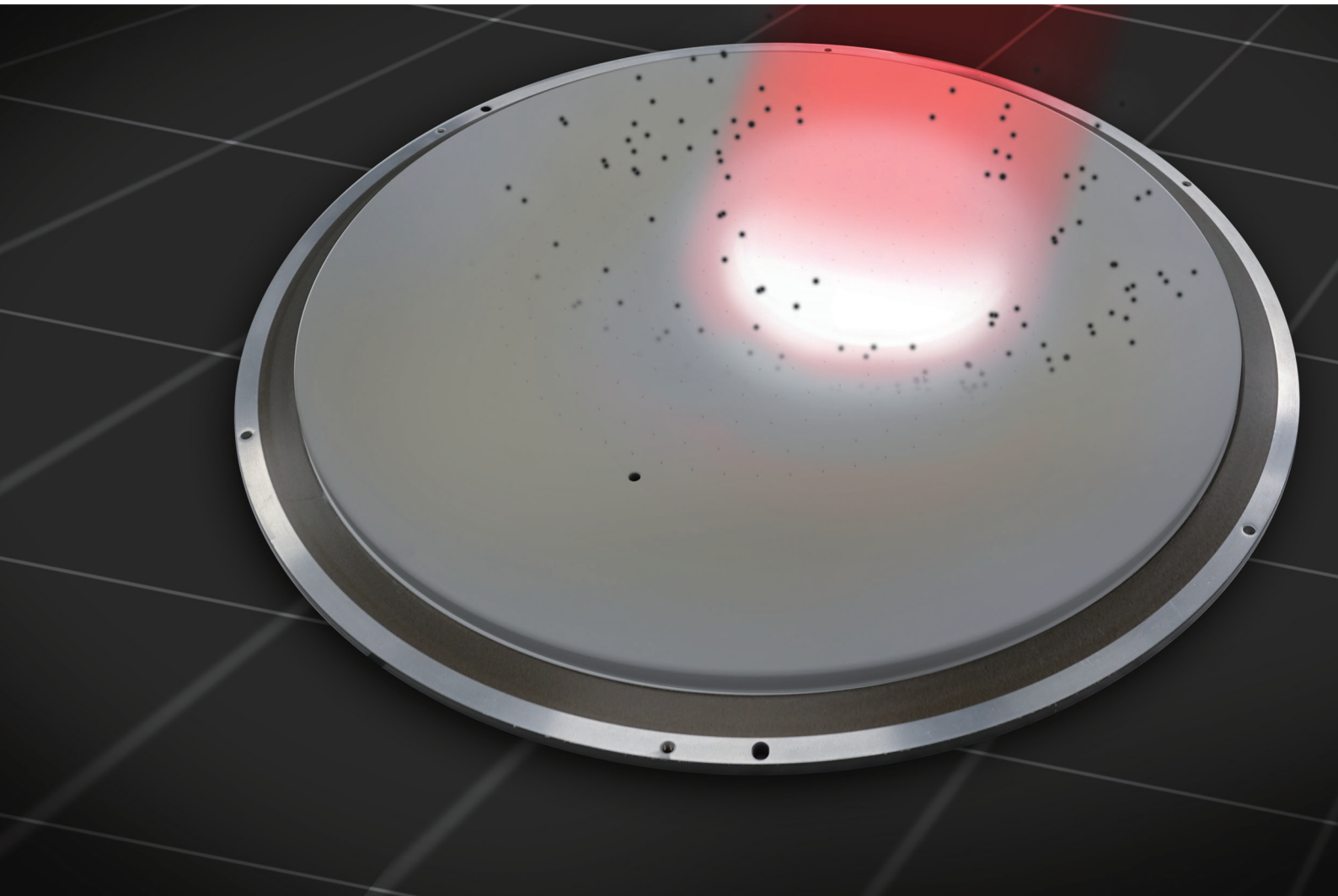


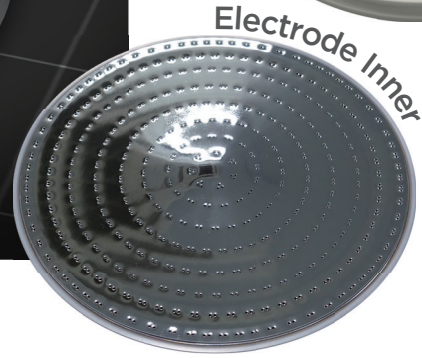
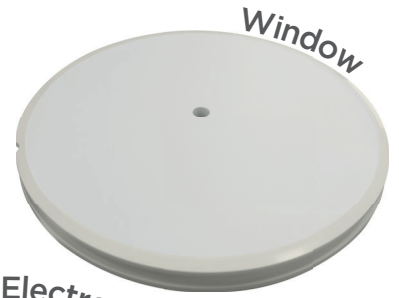
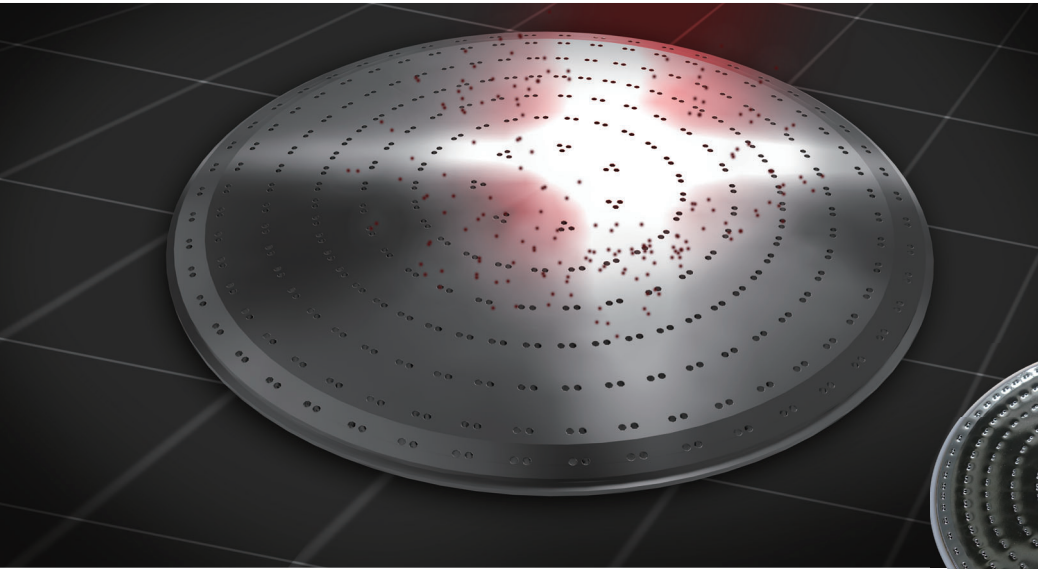
CINOS CLEANING TECHNOLOGY

Pulse Beam Clean

PBC™

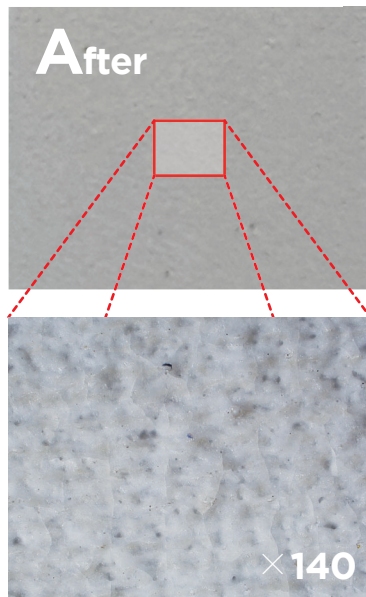
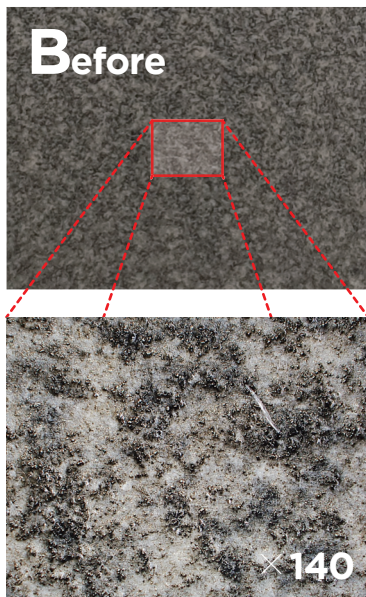
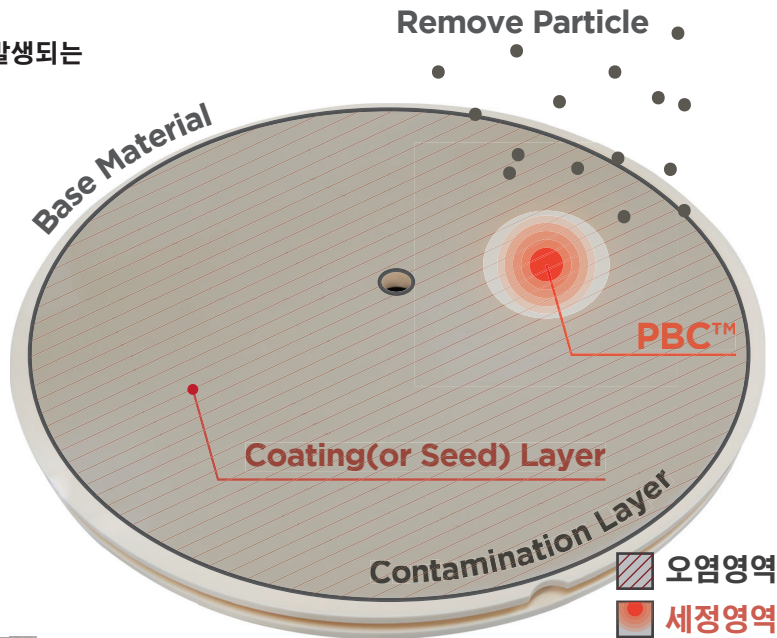
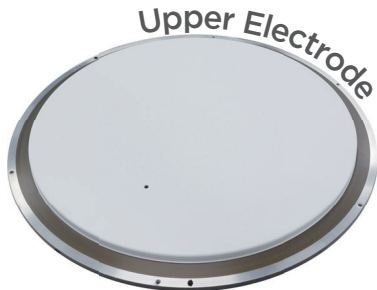


CINOS



일반적인 반도체 공정에서 사용되는 제품을 세정하기 위한 기술로는 물리 및 화학적 방식을 통한 세정 방식을 적용하고 있으나 기존 세정은 공정 부산물을 제거함과 동시에 모재 또한 식각, 변형되는 등의 문제가 발생하며, 이는 제품의 수명을 단축시켜 생산성이 저하되는 문제를 발생시킵니다.

PBC™는 Pulse Beam, Thermal, Micro Plasma를 통해 공정 상 발생하는 부산물을 선택적으로 제거하여 모재 및 코팅 영역의 Thickness, Roughness에 영향을 주지 않는 세정 방식입니다.



열 팽창 효과

오염물질과의 에너지 흡수 계수 차이
→ 열 팽창 계수 차이로 인한 박리



오염물질의 분해와 상변이

처리영역의 국소부위에 수천도의 고온을 생성하여 기화



펄스의 진동

처리영역 국소부위 기계적 공진을 생성하여 분해